



kingston.com/emcp

eMCP

Solusi penyimpanan terintegrasi dan hemat daya yang sempurna untuk aplikasi seluler, IoT, dan tertanam dengan ruang yang terbatas

Kingston menawarkan berbagai komponen eMCP standar JEDEC. eMCP mengintegrasikan penyimpanan Kartu MultiMedia Tertanam (eMMC) dan DRAM Laju Data Ganda Berdaya Rendah (LPDDR) ke dalam Kemasan Multi-Chip (MCP) dengan ukuran kecil. Solusi ini memungkinkan integrasi yang lebih baik sehingga mengurangi ukuran keseluruhan. eMCP adalah kombinasi komponen penyimpanan dan memori yang ideal untuk sistem dengan ruang terbatas, seperti smartphone, tablet, teknologi yang dapat dikenakan, dan perangkat "Internet of Things" (IoT).

KEUNGGULAN UTAMA

- Solusi flash NAND terkelola yang menyederhanakan desain dan penyediaan produk dengan antarmuka eMMC standar industri. Solusi ini secara signifikan mengurangi kompleksitas desain dan siklus kualifikasi.
- Kombinasi memori dan penyimpanan yang sangat terintegrasi meminimalkan penggunaan ruang pada desain sistem, menjadikan eMCP solusi yang ideal untuk aplikasi form faktor kecil.
- DRAM Low-Power mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan, menjadikan eMCP solusi optimal untuk berbagai aplikasi bertenaga baterai, seperti teknologi yang dapat dikenakan dan produk IoT seluler.
- Pengurangan jumlah komponen mengurangi kompleksitas Bill Of Material (BOM).
- Beberapa konfigurasi firmware tersedia untuk memenuhi persyaratan performa, daya, dan masa pakai aplikasi Anda.

SEGMENT PASAR



Smartphone dan Tablet



Teknologi yang Dapat Dikenakan



Akselerator AI



IoT

NOMOR KOMPONEN DAN SPESIFIKASI eMCP

eMCP berbasis LPDDR3

| Nomor Komponen | Kapasitas | | Standar | | Kemasan | FBGA | Suhu Operasi |
|----------------|-----------|-----------|---------|--------|---------------|------|--------------------|
| | NAND (GB) | DRAM (Gb) | eMMC | DRAM | (mm) | | |
| 04EM04-N3GM627 | 4 | 4 | 5.0 | LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 | 221 | -25°C hingga +85°C |
| 08EM08-N3GML36 | 8 | 8 | 5.1 | LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 | 221 | -25°C hingga +85°C |
| 16EM08-N3GTB29 | 16 | 8 | 5.1 | LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 | 221 | -25°C hingga +85°C |
| 16EM16-N3GTB29 | 16 | 16 | 5.1 | LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 | 221 | -25°C hingga +85°C |
| 32EM16-N3GTX29 | 32 | 16 | 5.1 | LPDDR3 | 11,5x13,0x1,0 | 221 | -25°C hingga +85°C |
| 32EM32-N3HTX29 | 32 | 32 | 5.1 | LPDDR3 | 11,5x13,0x1,1 | 221 | -25°C hingga +85°C |
| 64EM32-N3HTX29 | 64 | 32 | 5.1 | LPDDR3 | 11,5x13,0x1,1 | 221 | -25°C hingga +85°C |

eMCP berbasis LPDDR4x

| Nomor Komponen | Kapasitas | | Standar | | Kemasan | FBGA | Suhu Operasi |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|------|--------------------|
| | NAND (GB) | DRAM (Gb) | eMMC | DRAM | (mm) | | |
| 04EM08-M4EM627 | 4 | 8 | 5.1 | LPDDR4x | 8x9,5x0,8 | 149 | -25°C hingga +85°C |
| 16EM16-M4CTB29 | 16 | 16 | 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 | 254 | -25°C hingga +85°C |
| 32EM16-M4CTX29 | 32 | 16 | 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 | 254 | -25°C hingga +85°C |
| 32EM32-M4DTX29 | 32 | 32 | 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 | 254 | -25°C hingga +85°C |
| 64EM32-M4DTX29 | 64 | 32 | 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,0 | 254 | -25°C hingga +85°C |
| 128EM32-M4DTX29 | 128 | 32 | 5.1 | LPDDR4x | 11,5x13,0x1,1 | 254 | -25°C hingga +85°C |

